

立即发布

投资者关系：

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系：

Meggan Powers

企业宣传高级总监

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣布推出新的 CIRCL™ 集成系统

具有缺陷检测和测量的多功能组合系统

配合创新的 DirectedSampling™ 方法对各种芯片制程工艺进行高效监控

【加州米尔皮塔斯 MILPITAS 2012 年 4 月 23 日讯】 [KLA-Tencor 公司](#)（纳斯达克股票代码：KLAC）今天宣布，为前沿芯片制造商推出一套新的高产能缺陷检测 / 复查 / 量测系统——CIRCL™ 集成系统。这套新的集成系统专为光刻作业、出货质量控制 (OQC) 及其他制程模块而设计，不仅能检测晶圆的正面、背面及边缘缺陷，同时还能测量晶圆边缘轮廓、边胶同心性和初步的叠层对准误差。数据收集采用一种创新的 DirectedSampling™ 方法控制，可以根据需要，利用一次检测/测量的结果触发集成系统内其他类型的检测/测量。

KLA-Tencor SWIFT 部门总经理 Oreste Donzella 表示：“实现高端存储器芯片与逻辑芯片的成品率及性能目标需要对爆炸性数量的制程参数进行非常严密的监控。新的 CIRCL 集成系统同时兼顾所有晶圆表面，以极具成本效率的方式进行最恰当的组合测量。我们认为，CIRCL 的优势在于能够同时运用多种缺陷检查、复查与量测技术，帮助客户在发生制程偏移时找出并解决问题。”

CIRCL 集成系统结合了经业界证明的新一代 LDS 正面宏缺陷检测模块；基于 KLA-Tencor 旗舰 VisEdge™ 技术的新型边缘检测、轮廓描绘与量测模块；专用晶圆背面检测模块；以及灵活的光学缺陷复查与分类模块。这套 CIRCL 集成系统能够根据晶圆厂的特定制程控制需要进行配置。它的模块化结构减少了晶圆等待时间和晶圆厂空间，并设计了考虑到经济实用的现场升级需求。无论是现在还是在系统的整个使用期内，都能达到良好的投资回报率。

CIRCL 集成系统的广泛功能让晶圆厂工程师能够解决形形色色的成品率和芯片性能问题：

- 对晶圆正面多种类型的宏缺陷进行检测与分类，从颗粒到跨越多个 Die 的散焦缺陷，到全晶圆缺陷，例如光阻缺失；
- 较低百分比的非关键缺陷，让工程师能迅速和精准地处理生产材料；
- 光罩 ID 检查，以确保使用正确的光罩进行刻印；
- 初步的叠层对准误差监控，以检查层与层相对的图案对准；
- 检测晶圆背面的缺陷，这些地方的微粒与划痕有可能影响在晶圆正面光刻图案的线宽；
- 边缘缺陷的检测与分类，这些缺陷会迁移到晶圆的成品区，并造成成品率损失；
- 边胶去除 (EBR) 测量，用于监控薄膜的同心性和边缘完整性，以避免可能发生的剥落缺陷；
- 经校准的自动边缘轮廓测量，以查找在浸没式光刻期间会导致水珠泄露或薄膜分层的偏移；
- 晶圆正面和边缘缺陷的自动高分辨率光学缺陷复查与分类，帮助工程师迅速找到缺陷来源。

构成 CIRCL 集成系统的这些模块性能能够与其他 CIRCL 系统中的对应模块的性能匹配，以促进工作流程的选择性，并提升基的稳定性。为了保持高性能和高产能，CIRCL 集成系统由 [KLA-Tencor 的全球综合服务网络](#)提供支持。

CIRCL 模块已经发往领先的晶圆代工厂、逻辑芯片与存储器芯片制造商，用于先进的开发和生产线。关于 KLA-Tencor 的 CIRCL 集成系统的更多信息，请访问产品网页：
<http://www.kla-tencor.com/front-end-defect-inspection/CIRCL.html>。

关于 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司是制程控制与成品率管理解决方案的领先提供商，与全球客户合作，开发先进的检测与度量技术，为半导体、数据存储、LED、光伏及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，超过三十五年一直为客户努力打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部设在美国加利福尼亚州米尔皮塔斯 (Milpitas)，并在世界各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 www.kla-tencor.com (KLAC-F)。

前瞻性声明:

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 CIRCL 的预期性能，半导体产业的趋势及其带来的预期挑战，KLA-Tencor 的客户对 CIRCL 平台的预期使用，CIRCL 平台提供新功能的预期可扩展性，以及 CIRCL 工具使用者可以实现的预期成本、运营与其他受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港” (Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题），其他公司推出竞争性产品，或影响 KLA-Tencor 产品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制，因此实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###